

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2019-007

通富微电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员未提出异议；公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,153,704,572.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，公司总体经营情况良好，客户、产品结构不断优化，新产品研发及市场开拓逐步实现产业化，规模效应逐步显现。2018年，公司实现营业总收入722,286.30万元，比上年同期增加10.79%，营收增速在全球前十大封测公司中排名第二，在2018年全球前十大封测公司营收预估排名中由2017年的全球第七上升至全球第六。其中，崇川厂规模继续保持增长，营业收入同比增长6.27%；通富超威苏州、通富超威槟城营业收入合计同比增长9.85%；南通通富、合肥通富销售继续上升，同比增长分别达到133.28%、108.79%。

（1）受宏观政治与经济局势影响，终端客户对市场预期不明朗，备货谨慎，造成市场明显下滑，2018年第四季度，公司智能手机、消费类电子、汽车电子等终端产品需求低于预期，5G、物联网、AI等新兴行业尚未发力，影响了公司2018年第四季度营收。

（2）出于长远发展考虑，2018年公司加大了7纳米封测、Driver IC、Fanout、2.5D、服务器国产化等新兴应用领域技术产品的研发投资布局，全年研发费用投入较上年同期增加44.33%。

（3）公司向产业基金发行股份购买了产业基金持有的富润达49.48%股权和通润达47.63%股权，自2018年1月起，公司

合并通富超威苏州、通富超威槟城利润的比例由各22.49%提高至各85%，且通富超威苏州、通富超威槟城经营状况良好，2018年，通富超威苏州、通富超威槟城利润合计同比增长65.76%，对2018年归属于上市公司股东的净利润产生积极影响。

(4) 随着南通通富营收规模扩大，亏损较去年同期明显减少。

受上述因素综合影响，公司2018年全年收入虽保持增长，但全年营业利润及利润总额低于上年同期，实现营业利润11,450.74万元，比上年同期减少26.66%；实现利润总额12,367.05万元，比上年同期减少30.43%；2018年归属于上市公司股东的净利润12,693.96万元，同比增长3.94%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	7,222,862,993.75	6,519,255,165.45	10.79%	4,591,656,651.56
归属于上市公司股东的净利润	126,939,560.26	122,129,358.22	3.94%	180,814,573.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,513,128.00	3,248,193.62	1,208.82%	106,562,604.12
经营活动产生的现金流量净额	752,859,484.21	1,009,689,947.96	-25.44%	784,787,114.32
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%	0.19
加权平均净资产收益率	2.12%	3.07%	-0.95%	4.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	13,968,377,342.51	12,146,404,900.52	15.00%	11,203,124,861.10
归属于上市公司股东的净资产	6,134,345,314.38	5,919,382,239.15	3.63%	3,918,393,476.39

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,640,518,075.00	1,837,887,038.83	2,001,616,973.08	1,742,840,906.84
归属于上市公司股东的净利润	36,626,584.40	64,572,496.20	59,763,318.46	-34,022,838.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,449,170.08	51,281,196.41	50,335,802.93	-76,553,041.42
经营活动产生的现金流量净额	82,474,437.38	81,286,058.15	240,566,126.89	348,532,861.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,362	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

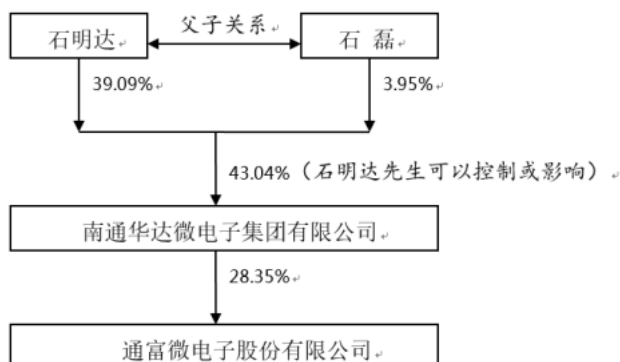
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	28.35%	327,041,893	0	质押	136,510,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	21.72%	250,621,589	181,074,458		
宁波梅山保税港区道康信斌投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	57,685,229	0		
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	57,685,229	0		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,268,200	0	质押	9,845,900
全国社保基金一一四组合	其他	0.68%	7,835,263	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,481,545	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	0.43%	5,000,000	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.34%	3,881,000	0		
泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	其他	0.26%	3,025,890	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 概述

2018年，公司实现营业总收入722,286.30万元，比上年同期增加10.79%，营收增速在全球前十大封测公司中排名第二，在2018年全球前十大封测公司营收预估排名中由2017年的全球第七上升至全球第六，排名提升1位。

(一) 市场开拓取得进步，产销保持增长

1、产品销售方面，WLP&BUMPING、FC、QFN、POWRE产品增速分别达到41%、21%、13%、11%，先进封装产品的占比超过70%。

2、围绕公司FCBGA、Bumping、Fanout、Driver IC、Memory、PA、IPM等新投资和优势产品线导入战略客户，进入5G、物联网、AI、电动汽车等具有高成长的应用领域。

(二) 各厂运营稳中有进

崇川厂规模继续保持增长，营业收入同比增长6.27%；12英寸Copper pillar CP顺利量产，形成Turnkey能力，提升了竞争力；Grade 0 车载品通过客户考核，车载品能力得到大幅提升；Gold Bump产线月产超千片，成为公司新的增长点。

南通通富营收较2017年增长了133.28%，具备了薄基板、4G PA封装能力及RF(射频)、低温测试能力；成功导入Fanout项目。

合肥通富2018年营收及产量较2017年翻倍，新导入客户20家，获三大客户最佳供应商奖；建立驱动电路CP、COG、COF产线，筹建存储器产线，为后续发展做好准备。

经过近三年的合作，公司与AMD的关系渐入佳境，展望未来，双方在业务方面的深度合作由3年延长至5年；双方合作范围进一步拓展，在现有封装及成品测试的基础上，增加Bumping、晶圆测试、减薄等环节，为AMD提供一站式服务；7纳米、MCM等高端新产品开发顺利推进；新产品的价格将体现更高的附加值；通富超威苏州、通富超威槟城有望承接更多的AMD订单。双方合作前景越来越广，为业界公认的近年来少数几个国际并购成功的典范。2018年，通富超威苏州、通富超威槟城营业收入合计同比增长9.85%，利润合计同比增长65.76%，成功导入AMD23个新品项目，具备全球7纳米芯片封测能力并成功实现量产；同时，成功开发多家优质新客户。

2018年11月，通富超威槟城收购FABTRONIC SDN BHD的100%股份，涉及收购金额不超过马币1,330万令吉（折合人民币2,205万元），增加公司东南亚生产基地的生产规模，以低成本扩张生产能力，为公司经营目标和未来可持续性发展的实现提供有力的保障。

（三）产品研发硕果累累

1、公司高端产品持续开发领先的解决方案和技术，进一步提升公司产品线的竞争优势。2018年，公司紧紧抓住5G和AI等新兴领域的需求，为中兴通讯等国内外客户成功开发了毫米波、超大功率等多款新应用产品。

2、全新产品和全新技术的开发与应用成为公司技术亮点，将培育成为公司新的增长点，为经营业绩的可持续发展奠定基础。

◆完成Fanout专线的建立，顺利通过内部可靠性测试并与合作客户成功开发六面包覆技术，公司已具备与世界大厂同等能力的Fanout晶圆级封装技术；

◆完成Gold Bump先进封装生产线建置，顺利通过多家客户审核验证，实现量产；

◆Driver IC CP测试产线组建完成，已具备8寸和12寸测试产能，已有两家客户验证通过；COF封装产线组建完成，最严苛产品规格试产成功，进入高端显示驱动芯片封装领域；

◆提供了NB-IoT面向物联网行业领先SiP解决方案，2018年，SiP NB-IoT制造的产品成功招标进入中国电信等运营商模组解决方案。

3、2018年申请专利共67件，公司拥有国内外发明专利近250件，其中美国发明专利授权量在国内同行中居第一，在南通各县市企业及科研院所中居第一。

（四）工程建设顺利进展

2018年工程建设总建设面积达到13万余平米，满足了公司整体生产运营的各项需要。其中，南通通富启动二期工程建设；通富超威苏州净化厂房扩大5,000平方米；厦门工厂一期主厂房封顶。

（五）争取政府支持，提升行业地位

2018年，公司以国家“02”专项、科技、技改、商贸、人才等项目为载体，获得各级政府财政资金支持超亿元；南通通富项目被列为江苏省重点项目，由江苏省委常委、组织部长挂钩指导推进；工信部授予公司“国家技术创新示范企业”，科技部授予南通通富、合肥通富“2018年国家高新技术企业”，公司荣获“崇川区区长质量奖”，顺利通过“南通市长质量奖”评选。

（六）发行股份购买资产，推动股权整合

2018年1月23日，公司向产业基金发行股份181,074,458股，产业基金成为公司的第三大股东；2018年2月27日，公司控股股东华达集团通过深交所交易系统以大宗交易方式增持了公司2%的股份，出售方是富士通中国；2018年5月7日，富士通中国将所持公司6.03%的股份转让予产业基金；将其所持公司5%的股份转让予南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）；将其所持公司5%的股份转让予宁波梅山保税港区道康信斌投资合伙企业（有限合伙）；至此，公司大股东华达集团与产业基金联合其他两家投资者一起买入富士通中国持有的公司股份，华达集团持股比例上升到28.35%，产业基金成为公司第二大股东，公司由中日合资企业，变为国家资本重点投资和扶持的集成电路封测领军企业，为公司今后长远发展奠定了坚实的资本基础。

富士通中国转让股份，不会对公司的生产经营和管理造成不利影响；大股东华达集团直接现金增持股份，体现出华达集团增强公司控制权的决心，也体现出华达集团对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；在新的产业发展形势下，国家资本的投资，对公司今后的发展至关重要。产业基金是以促进我国集成电路产业发展为目的而设立的专业投资基金，公司则在先进封装核心技术和关键工艺上拥有丰富的经验。通过上述股东变化，产业基金将进一步加强与公司的合作与联系，支持集成电路龙头企业发展，带动中国集成电路制造产业整体水平和国际竞争力的提升。

（二）公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

1、全球半导体市场发展趋势

作为一个具有周期性的行业，全球半导体产业在经历了2017年的爆发性增长和2018年的历史新高后，可能将迎来一段调整。根据摩根士丹利分析报告，当下半导体行业存货和供应过剩，实际产量从年初至今增加了22%，而市场消化量则为15%，需求端该如何消化这7%的过剩产能将是个很大的挑战。

半导体是全球高度分工的产业，其增长与全球的经济成长基本同步。基于上述行业特点，中美贸易摩擦给整个半导体产业链带来了较大的不确定性，造成信心不足。从市场供需来看，需求端的减弱是由于汽车和工业行业的垂直需求放缓以及整个供应链的库存调整。此外，智能手机方面的增长疲软，特别是来自苹果公司和中国厂商的需求减少，更是对半导体需求端的进一步施压。

全球范围内的经济增长放缓也将负面影响半导体行业。全球采购经理人指数（PMI）从2017年12月54.5的峰值下降至2018年11月的52。未来五年，半导体行业的增长率将围绕着GDP增长率上下波动。

根据世界半导体贸易统计机构（WSTS）发布的数据预测，2019年全球半导体市场规模可能增加到4,900亿美元，虽然年增速下滑至2.6%，但仍处于景气期。同时，随着我们的工业制造和日常生活不断向数字化、电气化、智能化方向演进，将给半导体产业带来更多的创新和发展机会。

2、中国半导体市场发展趋势

集成电路作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的基础，同时也是工业强基工程的重要支撑。中国半导体市场供不应求，进口依赖依然严峻。根据海关统计，2018年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%；进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%。出口集成电路2171亿块，同比增长6.2%；出口金额846.4亿美元，同比增长26.6%。

2018年，在存储器市场的带动下，全球半导体市场保持快速增长势头。国内半导体市场依旧保持高速增长，但增速有所放缓。展望2019年，随着存储器市场的供需关系逐渐趋于合理，继而带动全球产业增速逐步回落。预计2019年中国集成电路产业销售收入可达7764.4亿元，同比增长18.9%。可以看出，由于市场的巨大需求，同时考虑到相对较弱的产业基础，在行业调整的大背景下，中国集成电路产业增速仍将高于全球水平，持续形成局部热点，这一定会有利于国内集成电路封测企业的发展。

3、国内集成电路制造产线陆续投产

根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，目前全球处于规划或建设阶段，预计将于2017年~2020年间投产的半导体晶圆厂约为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。这些建于中国的晶圆厂2018年达到高峰，共13座晶圆厂加入营运，其中多数为晶圆代工厂。

随着国内集成电路新增产线的陆续投产，到2020年国内集成电路制造业增速将一直高于产业平均水平。我们认为相关的产业转移在未来的中长期将是一个可预期的趋势，将带动产业规模发展，芯片材料、芯片设计与芯片封装领域都将获得实质性的需求提升，将成为我国做大集成电路产业的催化剂。

4、终端应用领域带动行业发展

今年以来中国5G测试与商用的动作频繁，2019年将是5G承前启后的一年，其高速率、低延时、大连接的特征，将催化IoT、车联网、AI、VR/AR、云计算等应用渗透加速，带动硬件诸多环节受益。其中，在设备终端和硬件使用数量显著增长驱动下，传感器、MCU、功率、电源管理、射频、存储等半导体元件将迎来增量机会。

半导体行业未来长期增长点还存在于人工智能与新一代显示产品：1）人工智能的应用属于电子行业的下游，包括机器学习、自动驾驶等。目前的机器学习处于相对早期阶段，但是在接下来的3到5年中，将重点期望从用于算法、培训的半导体工具转向计算机解决方案，从而取代人力资本。人工智能/机器学习还有基于计算机视觉构建的Amazon Go概念店、可识别面部、车牌，甚至正在进行的犯罪的监控摄像头、医学放射学解释等应用；自动驾驶仍然是汽车设备制造商的一个重点领域。随着安全应用的迭代和技术的廉价化，全自动驾驶正在阶段性发展。自动驾驶还伴随着处理器、传感器（如Vision, Radar和LIDAR）的采用以及诸如车辆到车辆（V2V）通信等新技术的普及。这些技术将推动半导体在未来5到10年内单车应用价值上升2至3倍，从目前的整车400美元上升至1000美元。2）作为全球最大的液晶面板需求市场，中国已成为全球拥有高世代液晶面板生产线最多的国家，智能屏、触摸屏产量双双位居世界第一；当下，我国迎来了柔性屏时代，世界上第二条实现柔性屏批量生产的生产线，工厂面积接近7个“水立方”。

虽然国际形势的紧张正在减缓全球半导体产业的商品化进程，但最近中国逐步放开外国公司市场进入管制，此举增加了市场信心，也将鼓励中国半导体公司投入更多的研发经费来建立自己的专利。公司通过承担国家重大专项，具有一定的产品技术能力，公司将加快新产品开发与专利布局，将在SiP、Driver IC、Memory、CPU以及以扇出型和2.5D、3D为重点的先进封装技术方面发力，形成更小、更薄、更轻、更可靠、多功能、低功耗、低成本的先进封装产品系列；公司将研发新一代显示技术的驱动封装技术，重点扩展清洁能源、汽车电子产品；同时，围绕自主可控，后续还继续围绕打造虚拟IDM，推进集成电路上下游产业链建设，支持集成电路设备和材料国产化。

5、公司业务发展趋势

基于行业周期性波动特点以及行业长远发展趋势，我们对未来保持乐观。首先，中美贸易摩擦趋于缓和，有助于恢复信心；其次，市场调整过后，行业将迎来复苏。世界知名半导体厂商博通最近也表示，其半导体业务预计将在2019年第二财季触底；展望2019年下半年，其相信半导体业务将恢复，并实现强劲增长。2019年春节后，“公司原有业务”中的部分订单逐步回升，和博通对于行业的预测基本相符。

公司重要客户AMD发展势头强劲：一方面，AMD高端产品EPYC处理器在各个价格点上的性能都优于英特尔，出货量连续增长了一倍以上；另一方面，AMD的GPU业务迅速发展，已实现了创纪录的GPU数据中心收入。2019年，AMD将率先推出采用7纳米工艺、基于Zen2架构的全新处理器，性能将进一步提升。考虑到具有竞争力的产品组合，AMD预计2019年将继续是强劲的一年。通富超威苏州、通富超威槟城作为AMD最主要的封测供应商，其业务规模也将呈现高速增长。

综上，在外部政商环境稳定的情况下，我们预计，总体趋势稳中向好。

（二）公司面临的市场竞争格局

在市场竞争格局方面，目前国内集成电路封装测试企业已形成外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，国际大型半导体企业纷纷在华建厂，占据着一定优势。但同时，我国作为集成电路最大消费国，电子产品最大制造国，在政策鼓励下，晶圆厂的扩张计划和封测厂的并购整合持续推进，良好的产业环境有利于现有封测厂商提升其产能利用率及市场竞争力，提高其技术研发水平，内资封测厂商已开始具备进入全球第一梯队的基础。

（三）公司发展战略及规划

1、发展战略

面对以上市场竞争格局，公司紧跟市场与客户需求，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司总体战略为“立足本地、异地布局、兼并重组，力争成为世界级封测企业”。公司坚持发展主业的指导方针，提升主业盈利能力，采用“自身高质量发展+异地布局、兼并重组”相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级；坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业使命，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，力争成为世界级封测企业，努力使排名不断向前。

2、公司2019年度经营目标

公司计划2019年实现营业收入91.69亿元，较2018年实绩增长26.94%。该生产经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

2019年，公司面临挑战与机遇并存的大环境，将“练好内功”，迎接“春天”的到来。

（1）以创新的经营思维，抢订单，拓市场，扩销售

增强与市场及客户的互动，更好、更清楚地了解市场需求和竞争力状况，让客户更早、更深入地认识公司的产品和技术，最大程度提高客户满意度；保持和发展公司已有竞争力强的产品，继续扩大业务和增加市占率；充分利用通富超威地理位置、技术和产品的优势，吸引世界一流客户在槟城和苏州开展更多新业务。

（2）抓住发展重点，提升核心竞争力

通过强有力的组织实现Driver IC、FO、Gold bumping、memory等产品产业化；加强与AMD的合作，争取Bumping+Wafer sorting更多订单；致力于7nm高端服务器等新技术的开发与应用，争取更多中国芯的订单以及FO、2.5D的订单；扩增东南亚基地生产规模，以低成本扩张生产能力；继续推进厦门通富、南通通富基地建设；在南通中创区设立先进封装测试技术研究所、物联网(IOT)技术研究所，为机遇来临时做好准备。

（3）加快人才培养，努力实现人力资源高水平发展

重视急需的高中高端技术管理人才、团队的引进，确保公司重点项目的顺利推进；重视后备干部和接班人的培养，通过“通富学院”，有计划进行接班人、后备干部的培训培养；强化对各级各类人才的使用、管理和考核。

3、为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做适当准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富超威苏州及通富超威槟城计划2019年在设施建设、生产设备、动力供应、IT、技术研发等方面投资共计17.58亿元。

公司与合肥政府、厦门政府建立了合作关系，厦门通富注册资本8亿元全部出资到位；合肥通富实际出资17.85亿元；苏通工厂已获得1.56亿国家专项建设基金支持；公司与商业银行及政策性银行均保持长期密切合作；这些支持，为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

（四）公司的风险因素及应对措施

1、行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业与市场波动给公司带来的经营风险。

2、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。公司通过承担国家“02”专项、收购AMD封测资产，已经取得一定的科研成果，已经具备了提供大规模先进封测的能力。但公司研发的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过引进高层次研发人才、并购高端封测资产，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。

3、原材料供应及价格变动风险

公司封装测试所需主要原材料为引线框架/基板、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

4、外汇风险

2016年、2017年及2018年，公司出口销售收入占比分别为84.48%、82.47%、86.41%，外销收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路封装测试	7,163,561,570.81	80,276,697.62	15.55%	11.03%	-33.38%	1.49%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

经公司第六届董事会第二次会议审议，公司变更了按组合计提坏账准备的应收款项，将合并范围内关联方应收款项从账龄组合中分拆出来，做为无风险组合，不再计提坏账准备。自2018 年 1 月 1 日开始实施。此项会计估计变更对合并财务报表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-3 月净利润（万元）	-5,493.99	至	-3,662.66
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,662.66		
业绩变动的原因说明	2019 年 1、2 月份市场延续 2018 年 4 季度下滑趋势，导致公司营收较同期下降；公司重要客户芯片因质量问题供应不畅影响了订单释放，预计 2019 年 1-3 月净利润下降。		

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2019 年 3 月 28 日